

SdK-Unternehmens- präsentation – SUSS MicroTec SE



Das Unternehmen im Überblick





SUSS auf einen Blick

- Hidden Champion mit Hauptsitz in Deutschland und einer 75-jährigen Erfolgsgeschichte in Bezug auf Innovation und Wachstum
- Schlüsselanbieter von Technologien für das Frontend und Advanced Backend der Halbleiterbranche
- Globale Kundenbasis mit > 75% Umsatzanteil in Asien
- Strategischer Partner für weltweit tätige Halbleiterhersteller (IDMs) und Auftragsfertiger (Foundries)
- Innovator mit gut ausgebautem Netzwerk zu renommierten Forschungsinstituten und Universitäten

SUSS ist Teil unseres digitalen Lebens!



Das Unter- nehmen in Zahlen

8.000
Systeme

446,1
in Millionen €

423,7
in Millionen €

~1.500
Mitarbeitende

Weltweit mehr als
8.000 installierte
Systeme

Umsatz im
GJ 2024

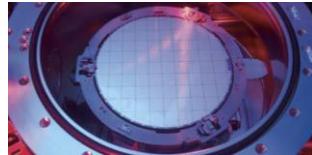
Auftragseingang im
GJ 2024

Zum 31.12.2024, davon
59% in EMEA, 36% in
APAC und 5% in
Nordamerika

Meilensteine unserer Unternehmensgeschichte

**1949**

Gründung der Karl Süss KG in München

**1990**

Start der Serienproduktion von Wafer-Bondern

**2000**

Integration von Beschichtungssystemen durch Akquisition von Fairchild Technologies

**2010**

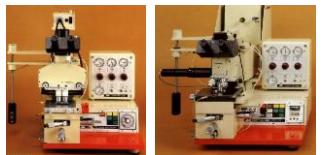
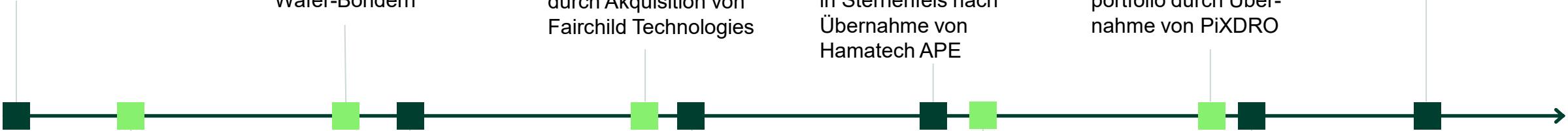
Eröffnung des zweiten deutschen Standorts in Sternenfels nach Übernahme von Hamatech APE

**2020**

Aufnahme des Inkjet-Drucks ins Leistungsportfolio durch Übernahme von PiXDRO

**2024**

Relaunch der Marke als SUSS

**1963**

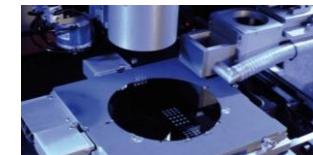
Entwicklung des weltweit ersten Mask-Aligners SUSS MJB3

**1999**

Börsengang an der Frankfurter Börse

**2001**

Umbenennung des Unternehmens in SÜSS MicroTec

**2012**

Ergänzung der Laserprozessierungstechnologie nach Akquisition von Tamarack Scientific

**2020**

Eröffnung des asiatischen Produktionsstandorts in Hsinchu/Taiwan

 Meilensteine des Unternehmens Meilensteine der Technologie

Vorstand



CFO
Dr. Cornelia Ballwießer

- Finanzen und Controlling
- Recht und Compliance
- Risikomanagement
- Investor Relations
- IT
- ESG



CEO
Burkhardt Frick

- Vertrieb und Service
- Strategie
- HR
- Interne Revision
- Business Units:
Advanced Backend Solutions,
Photomask Solutions



COO
Dr. Thomas Rohe

- R&D
- Einkauf
- Produktion
- Logistik
- Qualitätsmanagement
- Produkt-Center
- Facility Management

Unsere zwei Geschäftsbereiche, mit vollem Fokus auf die Halbleiterbranche

Frontend

Bereiche

Photomask Solutions



Advanced Backend

Advanced Backend Solutions



Produkte

Photomask Equipment



MaskTrack X

Imaging



Mask Aligner
MA200/300



Projection
Scanner
DSC300

Coating



ACS300

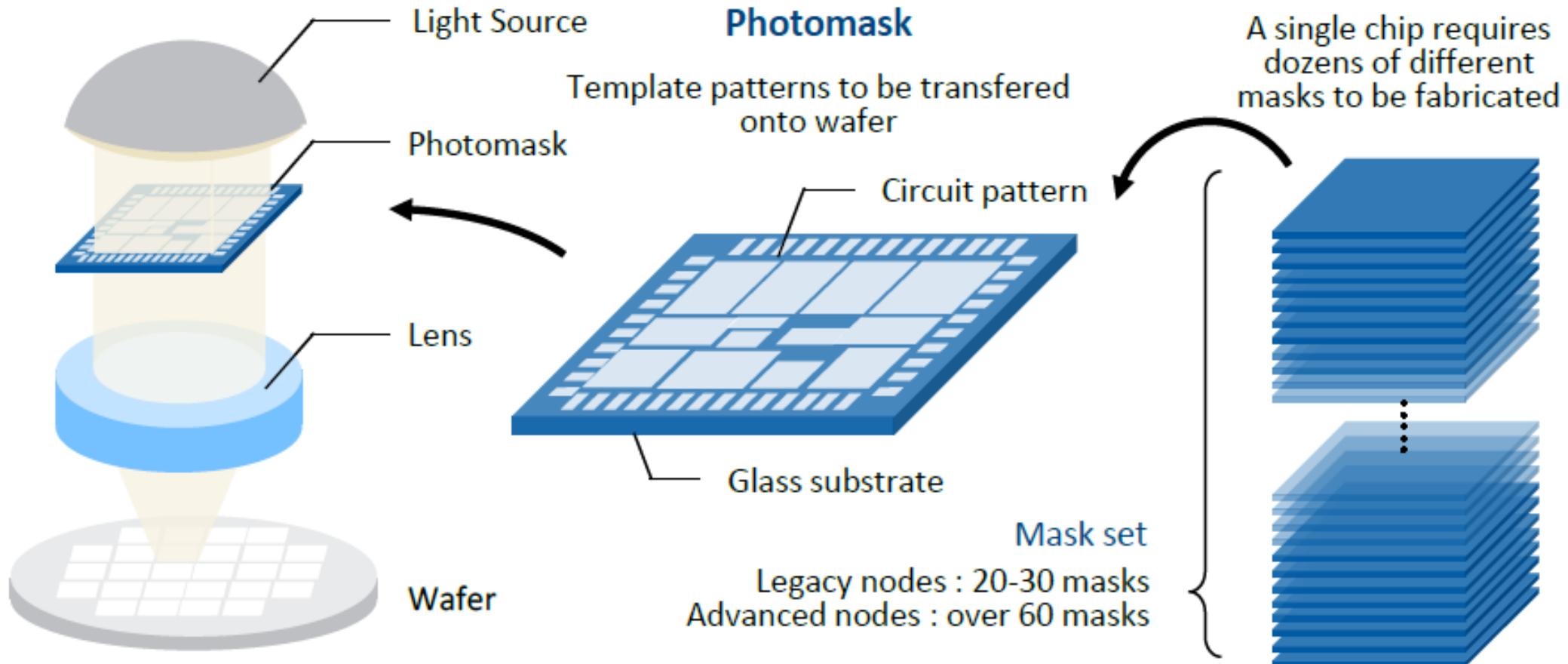


XBC300



XB8

Unsere Kernkompetenz liegt darin, lithografische Fotomasken und Wafer zu prozessieren



Source: Morgan Stanley Research

Advanced Backend Solutions

Portfolio-Highlights – Imaging Systems

MASK
ALIGNER

MA/BA8 Gen4

PROJEKTIONSSCANNER



DSC300 Gen3

MASK
ALIGNER

MA200 Gen3

Mit über 60 Jahren Innovationserfahrung bietet SUSS erstklassige Belichtungslösungen vom Labor bis zur Großserienproduktion.

MASK
ALIGNER

MA300 Gen3

Advanced Backend Solutions

Portfolio-Highlights – Coating Systems



ACS200 Gen3 TE



ACS300 Gen2



ECD8



JETx



ACS200 Gen3 TE -
JETx

SUSS ermöglicht die Auswahl zwischen Lösungen für Rotationsbeschichtung, Sprühbelackung oder Tintenstrahldruck – ganz nach Anwendungsbedarf.

Advanced Backend Solutions

Portfolio-Highlights – Bonding Systems

PERMANENT-
WAFER-
BONDEN

XBS200

HYBRID-
WAFER-
BONDENXBC300 Gen2
D2W/ W2WTEMPORÄR-
WAFER-
DEBONDEN

XBC300 Gen2

SUSS ist Marktführer für Temporär-Bond- und Debondlösungen. Anlagen für das Permanent- und Hybridbonden ergänzen das Portfolio.

TEMPORÄR-
WAFER-
BONDEN

XBS300

Photomask Solutions

Portfolio-Highlights



HMx Series



ASx Series

Reinigung
Stripping
Entwicklung
PEB



MaskTrack Smart BD

Bake
Entwicklung
KI-Analyse



MaskTrack X GB

Entfernung
des Pellikel-
klebers



MaskTrack PRO / X

Reinigung
Stripping
Entwicklung
PEB

Wir bieten Fotomasken-
lösungen vom Labor bis zur
Großserienproduktion –
skalierbare Lösungen, die die
nächsten Technologieknoten
unterstützen können.

Wir sind ein Weltkonzern mit lokaler Präsenz



Nordamerika

USA

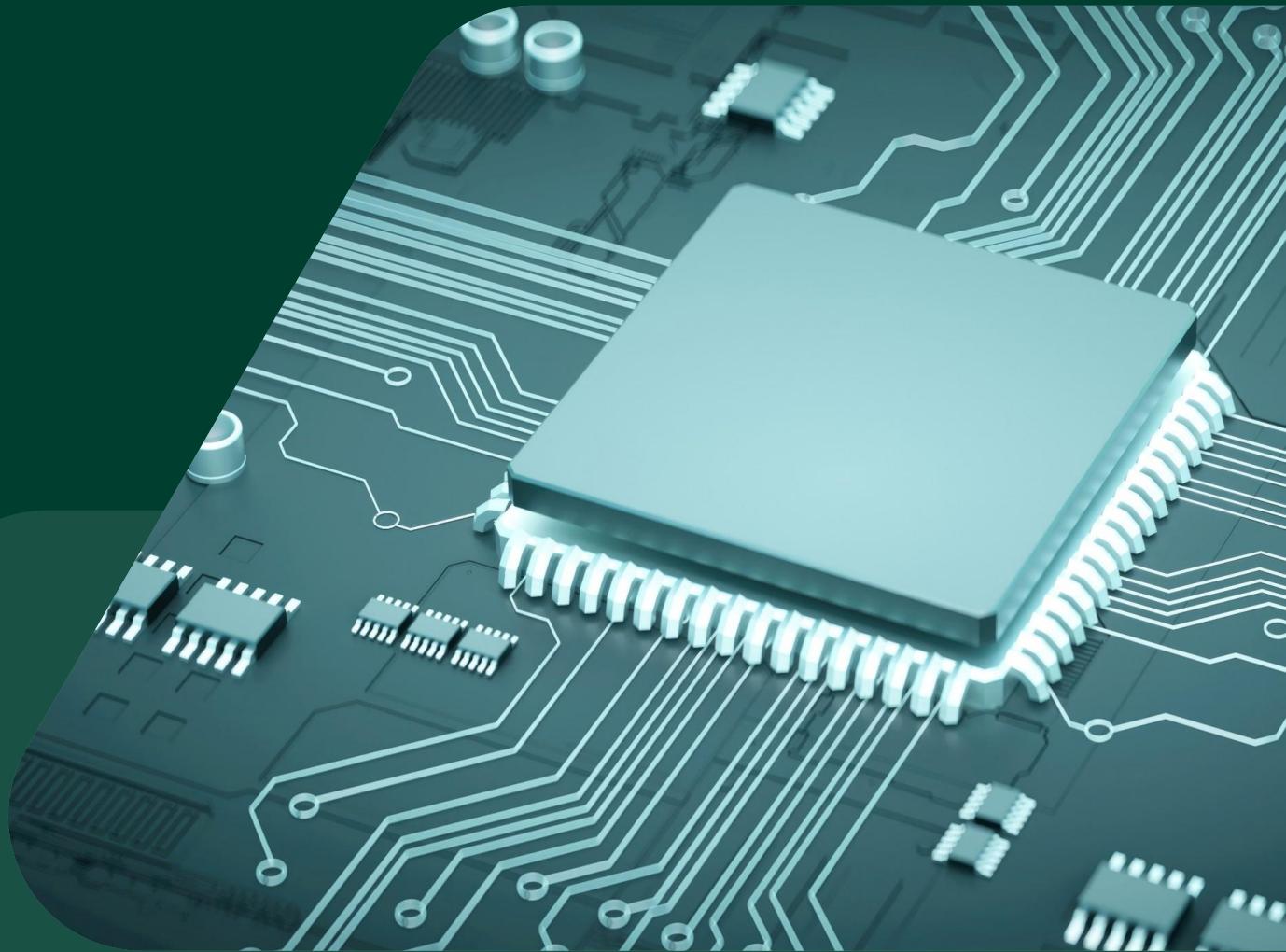
Europa

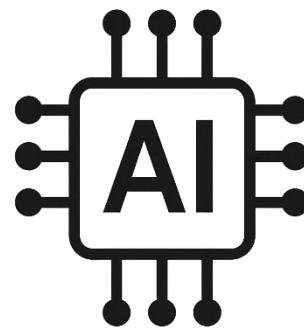
- (HQ) Deutschland
- Vereinigtes Königreich
- Niederlande
- Frankreich

Asien

- Japan
- Korea
- China
- Taiwan
- Singapur

Marktüberblick

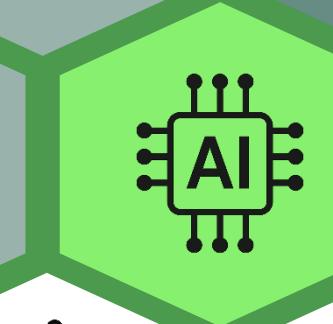
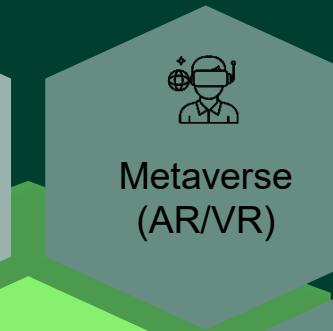




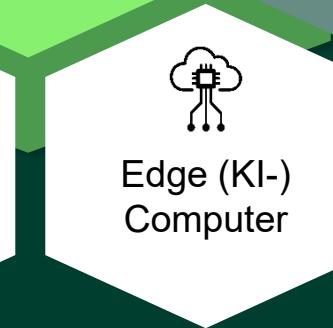
**Technologietrends,
beschleunigt durch KI,
basieren auf Halbleitern**
und treiben das schnelle Wachstum
im Halbleiter-Ökosystem voran

Trendauswahl – nicht vollständig

Mobilität

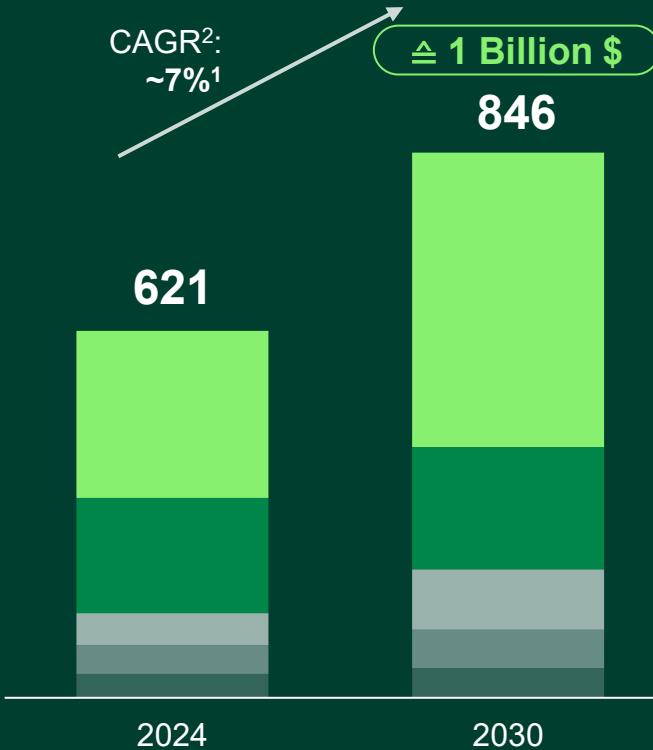


Wirtschaft



KI-gestützte, langfristige Trends treiben die Halbleiterbranche bis zu einer Marktgröße von 1 Billion US-Dollar im Jahr 2030 voran

Prognose für den Umsatz mit Halbleitern (in Mrd. €) & Treiber



Marktsegment	Wachstumstreiber	Haupttreiber für Wachstum
Computer & Daten-speicherung	 KI (Generative-, Agentic-, Physical-AI)  Autonomes Fahren  Industrielle Automatisierung / Internet der Dinge  Metaverse (AR/VR)	Haupttreiber für Wachstum
Kommunikation	 Hyperkonnektivität – 6G	
Automobil-industrie	 Softwaredefinierte Fahrzeuge / Autonom. Fahren  Elektrifizierung der Automobilindustrie	
Industrie	 Industrielle Automatisierung / Internet der Dinge  Elektrifizierung / Öko-Stromerzeugung	
Konsumenten-märkte	 Metaverse (AR/VR)  Wearables für das Gesundheitswesen	

¹ Basierend auf US-Dollar-Werten; ² CAGR = Compound Annual Growth Rate = durchschnittliche jährliche Wachstumsrate

Quellen: SUSS Recherche; Marktgröße basierend auf Yole (2025); Hinweis: USD/EUR Wechselkurs-Kalkulationsbasis = 1.18, USD/EUR 2024 Wechselkurs = 1.08

Steigende Anforderungen verwischen die Grenzen zwischen Frontend und Backend, was in unserer Business Unit-Strategie verankert ist

Frontend

Reduzierung der Technologieknoten: Moore's Law setzt sich fort, wobei die Knoten in Richtung Ångström-Ära schrumpfen

Backend

Advanced Packaging: Entwicklung und breite Einführung heterogener Chiplet-Technologie

Höhere Genauigkeit und Sauberkeit führen Kundenanforderungen näher an Frontend-Standards heran

Effiziente und umweltfreundliche Prozesse:

Steigende Kundennachfrage nach reduziertem Materialverbrauch und umweltfreundlichen Materialien

Photomask
Solutions

Photomask Cleaning, Bake & Develop

Wafer Cleaning

Advanced Backend
Solutions

Bonding, Coating & Imaging

2.5/3D Chiplet Technologie | SUSS ist gut positioniert, um von der hohen Dynamik im Bereich der 2.5D- und 3D-Entwicklung zu profitieren

Temporary Bonding

- **HBM:** Strukturelle Unterstützung beim Dünnen

Hybrid Bonding

- **HBM:** Stapeln der DRAMs¹
- **CPO:** Stapeln der PIC & EIC¹
- **SoIC:** E.g., Logic-on-Logic¹

Inkjet-/ Spin Coating

- **TIV:** Lithografie
- **RDL:** Lithografie¹

UV-Scanner (Exposure)

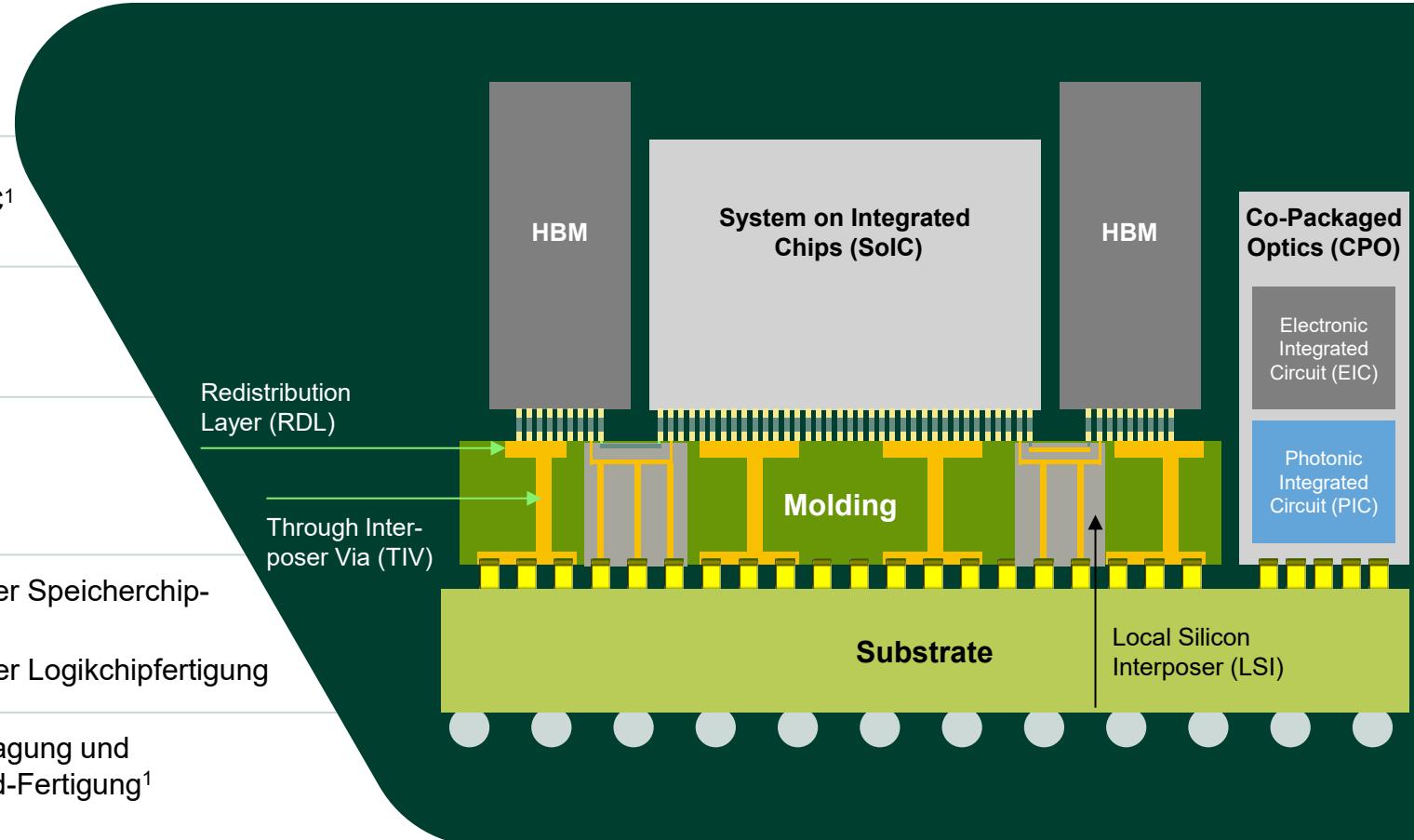
- **TIV:** Lithografie
- **RDL:** Lithografie¹

Photomask Cleaning (Frontend)

- **HBM:** Maskenreinigung in der Speicherchip-Fertigung
- **SoIC:** Maskenreinigung in der Logikchipfertigung

Wafer Cleaning

- **HBM:** Kritische Materialabtragung und Endreinigung in der Backend-Fertigung¹



¹ Mögliche zukünftige Anwendungsfälle

● BU Advanced Backend Solutions

● BU Photomask Solutions

Effiziente & grüne Prozesse | Nachfrage nach ESG-konformen Anlagen steigt



Null-Emissionswachstum bis 2025, und Erreichen der Netto-Null-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 2050.

TSMC **minimiert** kontinuierlich den **Ressourcenverbrauch an der Quelle**, passt die Parameter für den Rohstoffverbrauch und technische Lösungen für Prozessverbesserungen an und kollaboriert mit Lieferanten zur **Materialoptimierung und -minimierung**



Absolute Reduzierung der betrieblichen Emissionen um 42 % bis 2030 (ggü. 2020) und Netto-Null-Emissionen bis 2050.



Amkor verpflichtet sich, die absoluten **Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) bis 2033 um 55 % gegenüber 2022 zu senken**.

Netto-Null-CO2-Emissionen entlang der Wertschöpfungskette bis 2050.



Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von Produkten (Cradle to Grave)



Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Kunden, um den CO2-Fußabdruck über alle Lebenszyklusphasen hinweg zu reduzieren.

Materialsparende Prozesse



Wir haben Verfahren/Anlagen entwickelt und entwickeln diese weiter, um den Einsatz schädlicher Materialien zu reduzieren.– z.B.

- **Inkjet** spart >50% Coating-Material,
- **Pellicle Glue Buster** reduziert den Verbrauch von Säuren um bis zu 1.000 mal (Maskenreinigung)

Verwendung umweltfreundlicher Materialien



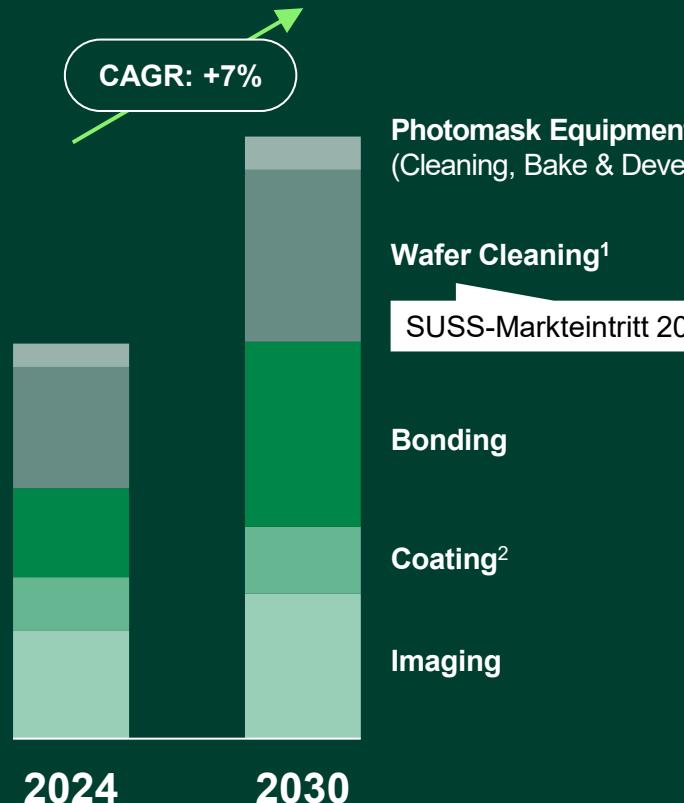
Wir haben Verfahren/Anlagen entwickelt und entwickeln diese weiter, um schädliche Materialien zu ersetzen – z.B. bei der Waferreinigung.

- **Ersatz schädlicher Lösungsmittel auf Erdölbasis** durch innovative Flüssigkeiten auf Wasserbasis
- **Zersetzung organischer Stoffe durch UV-Licht –** Keine schädlichen Rückstände bleiben zurück

Quellen: Unternehmenswebseite und Jahresberichte

Bedienbarer Markt wird bis 2030 voraussichtlich um ~7 % p.a. wachsen

Bedienbarer, verfügbarer Markt (Umsatz in Mio. €)



Photomask Solutions

Advanced Backend Solutions



Photomask Equipment

- Wachstum im High-End-Markt f. Maskenreinigung
- Mittleres bis hohes einstelliges Wachstum (in % p.a.) im Markt für Mid-End-Maskenreinigung



Wafer Cleaning

- Markteinstieg mit MEMS, Power & CMOS Image Sensors; Expansion ins Advanced Packaging mit 300 mm-Tool geplant (Tool-Launch im Jahr 2027)
- Speicherchips – Zukunftspotenzial (in Marktgröße unberücksichtigt)



Bonding

- Temporäres Bonding wird weiter wachsen, vor allem aufgrund der hohen KI-Nachfrage
- Hybrid Bonding mit großem Wachstumspotenzial, getrieben durch Logik-/Speicherchips



Coating

- Advanced Packaging treibt Wachstum im Backend-Coating voran
- Inkjet bietet Potenzial außerhalb des klassischen Coatings, Eintritt in die additive Fertigung



Imaging

- Advanced Packaging sorgt für Wachstum; größere Chips/Packages unterstützen Adaption von (Full Field) Projektionsscannern

¹ MEMS, Power, CMOS Image Sensors & Advanced Packaging Markt berücksichtigt; ² Nur Backend-Coating-Markt; Inkjet: Potenzial durch Expansion in additive Fertigung nicht berücksichtigt | Quelle: SUSS Recherche, insbesondere basierend auf Yole

Ambition 2030



Unsere neuen langfristigen Ambitionen bis 2030

€ 750 – 900 m

43 – 45%

Bruttomarge
SUSS Ambition 2030

+ ~8%-Punkte Bruttomargen-
Steigerung (verglichen mit
Prognose 2025)

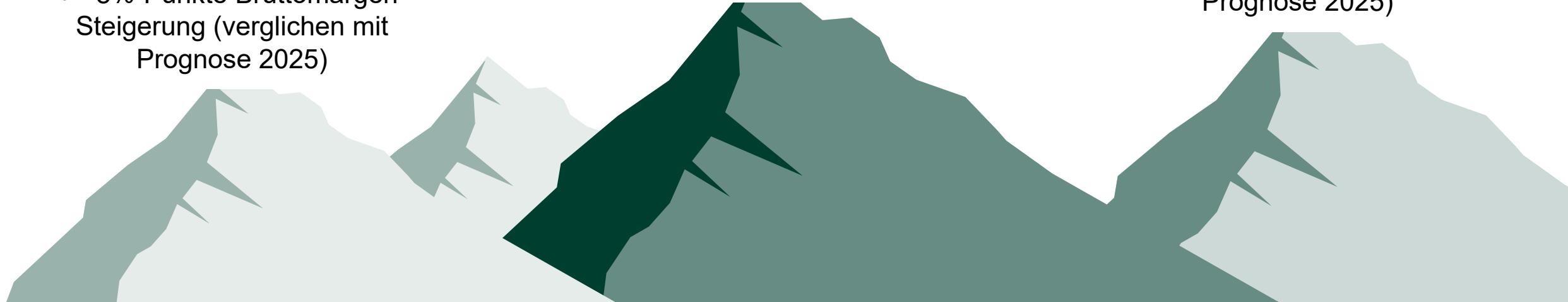
Umsatz
SUSS Ambition 2030

~ 9 –13% Umsatzwachstum
p.a. (verglichen mit
Prognose 2025)

20 – 22%

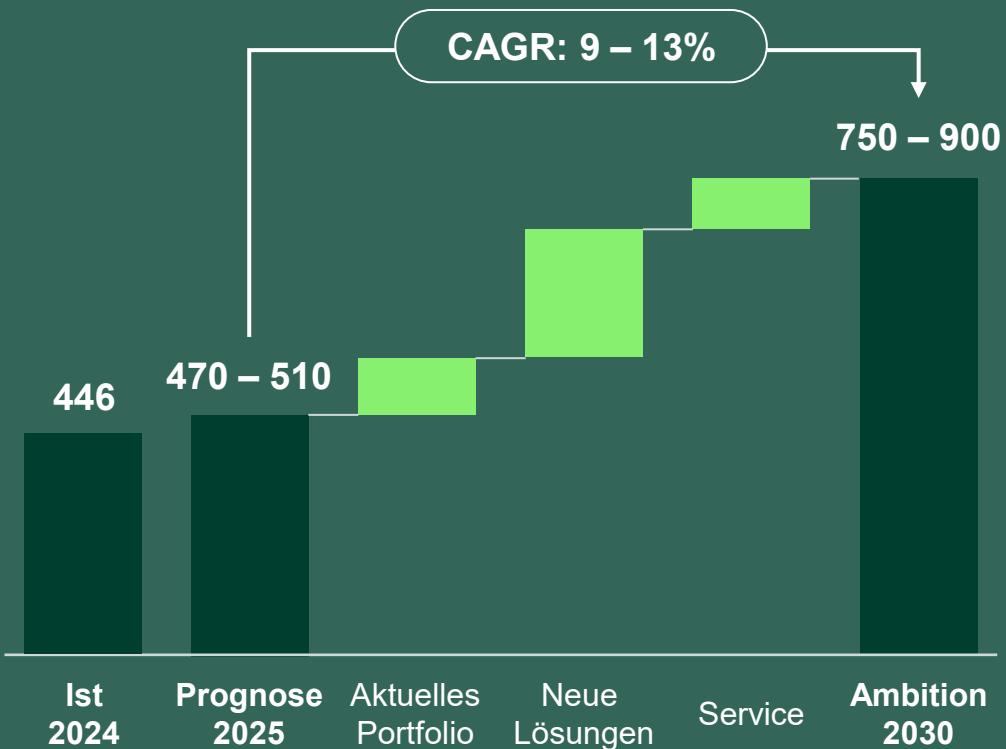
EBIT-Marge
SUSS Ambition 2030

+ ~9%- Punkte EBIT-Margin-
Steigerung (verglichen mit
Prognose 2025)



Wachstum auf Basis eines sich stark entwickelnden Portfolios, neuer Lösungen und eines gestärkten Service-Geschäfts

Umsatzentwicklung (in Mio. €)



Aktuelles Portfolio – Hauptwachstumstreiber:

Photomask Equipment

#1 im High-End-Segment bleiben und führende Marktposition auf Mid-End-Bereich ausweiten

Temporary Bonding

Führungsrolle behaupten – insbesondere im Bereich HBM

UV-Scanner

Erweiterung der Präsenz im Advanced Packaging, #1-Position bei führender Foundry als Hebel nutzen

Neue Lösungen – Hauptwachstumstreiber:

Wafer Cleaning

Markt für Wafer Cleaning mit innovativer, kosten-effizienter und nachhaltiger Lösung betreten

Hybrid Bonding

Eintritt in den Advanced Logic and HBM-Markt, unterstützt durch exzellenter Technologie

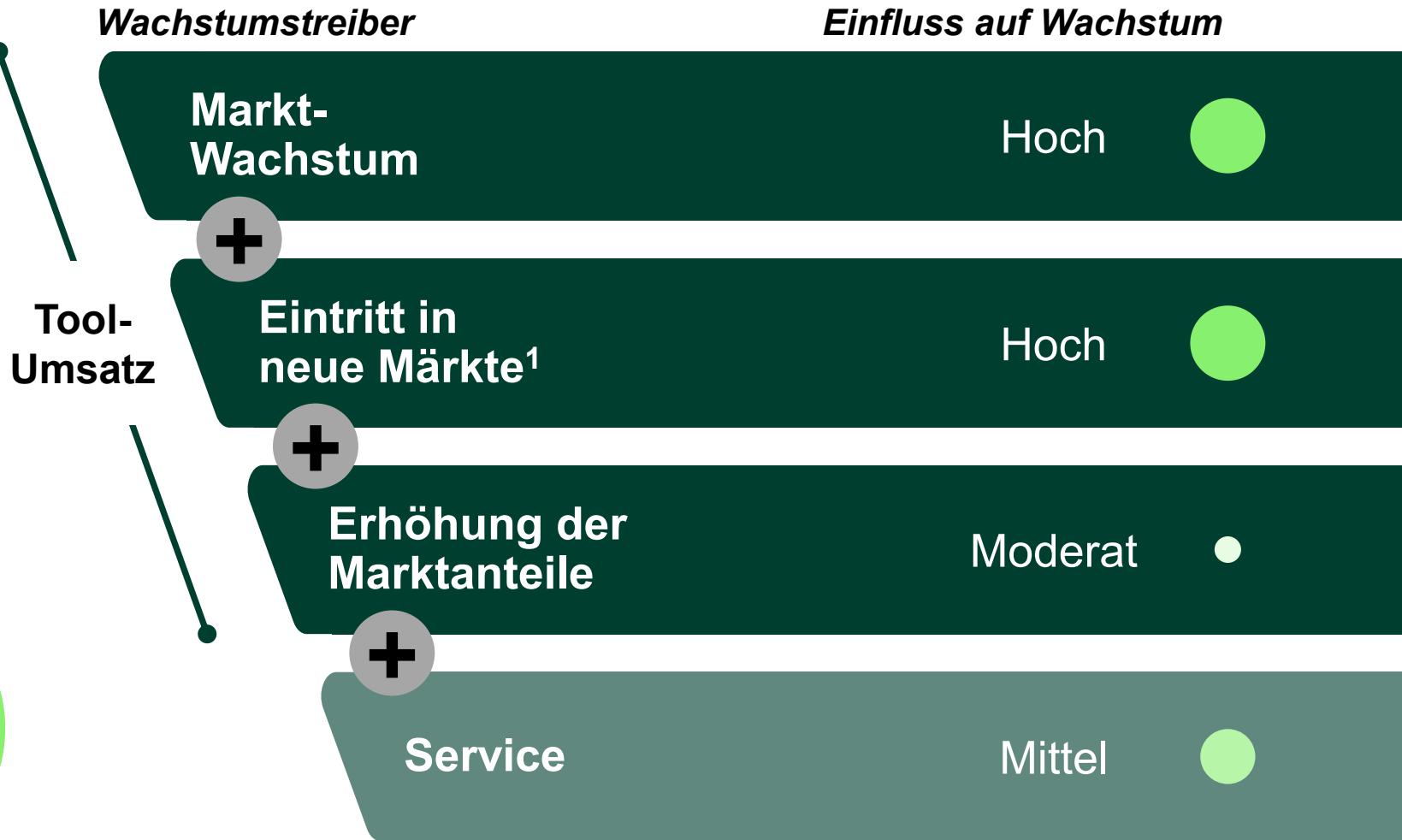
Inkjet Coating

Inkjet-Markt ebnen – mit smarten Lösungen für Coating und für die additive Fertigung

Service – Hauptwachstumstreiber:

Umsatzanteil von 18 auf 25 % steigern, indem Service zu einem strategischen Treiber für die Geschäftsentwicklung wird

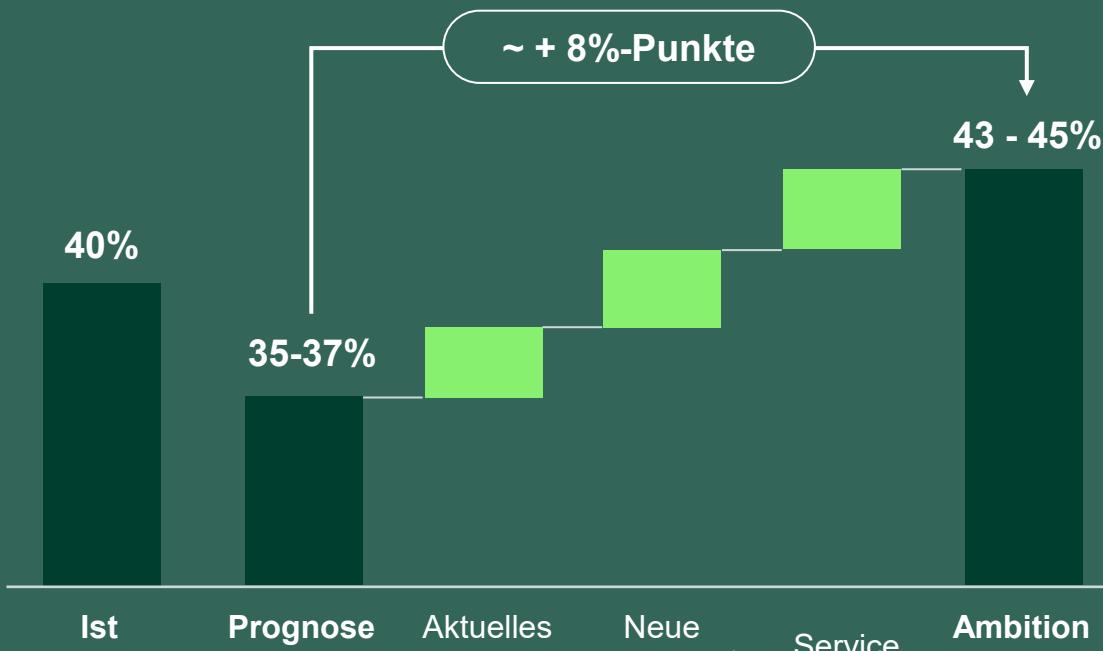
Wachstumskurs gestützt durch KI-getriebenen Marktaufschwung und kontinuierliche Expansion in neue Segmente



1) Wafer Cleaning & Hybrid Bonding

Ausgewogene Margenverbesserung durch das bestehende Portfolio, durch neue Lösungen und durch das Service-Geschäft

Entwicklung der Bruttomarge (in %)



1) Wafer Cleaning, Hybrid Bonding & Inkjet

Aktuelles (und sich weiterentwickelndes) Portfolio:

- Neue, modulare und standardisierte Produktgenerationen (z.B. neuer Mask Cleaner, UV-Scanner und Mask Aligner)
- Optimiertes Produktionsnetzwerk und weiter verbesserte Kapazitätsauslastung

Neue Lösungen:

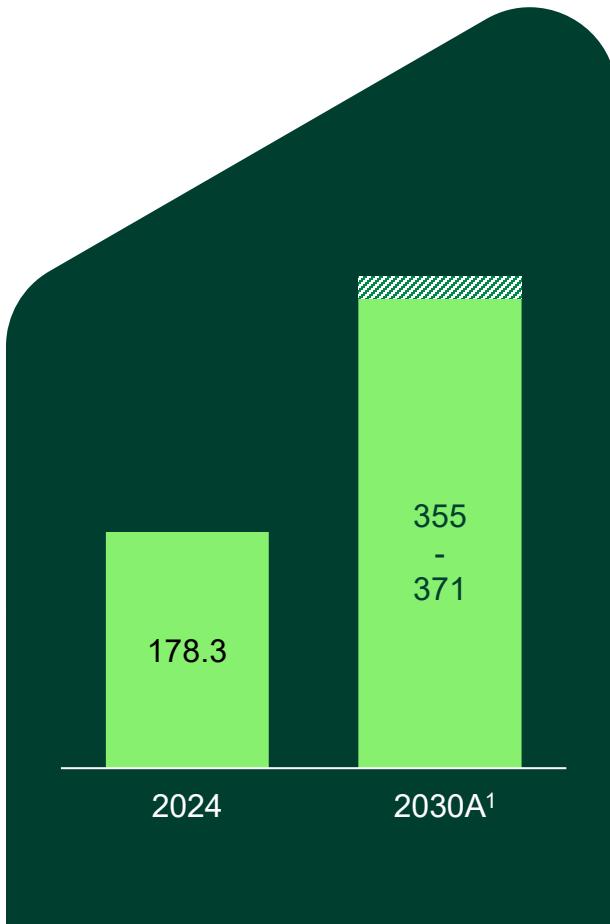
Neue Produkte mit höheren Margen (verglichen mit dem aktuellen Portfolio) aufgrund eines neuen Anlagendesigns (Ausnahme: Hybrid-Bonder, bei dem das Die-Bonding-Modul extern bezogen wird)

Service:

Verbesserung der Marge durch strategischeres Management der installierten Basis und fokussiertes Service-Produktportfolio

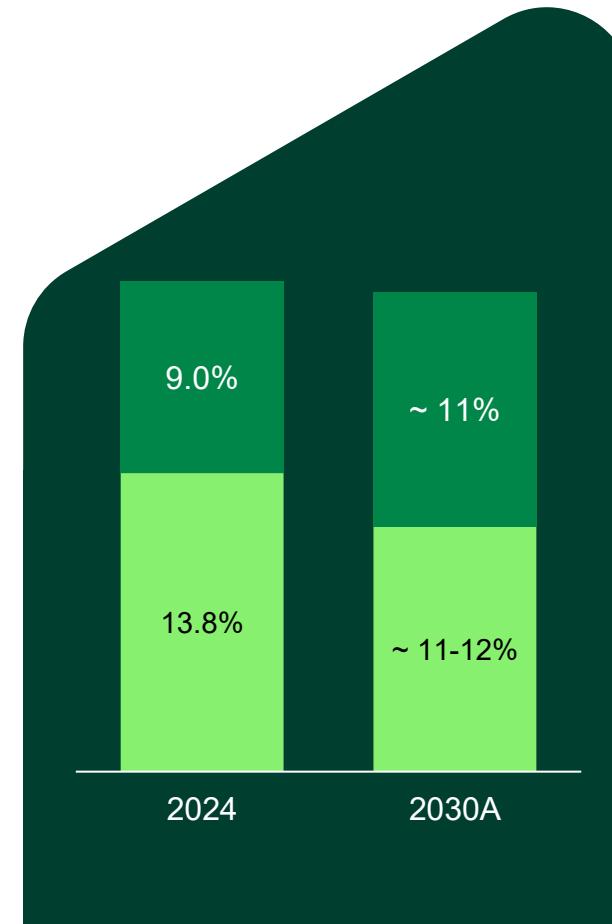
EBIT-Marge profitiert von einem höheren Geschäftsvolumen – gleichzeitig steigende F&E-Ausgaben und sinkende Vertriebs- und Verwaltungskosten erwartet

So wollen wir die angestrebte EBIT-Marge von 20 bis 22 % erreichen



Steigerung des Bruttoergebnisses vom Umsatz

Das **Bruttoergebnis vom Umsatz** könnte sich von 2024 bis 2030 verdoppeln, unterstützt durch ein größeres Geschäftsvolumen mit verbesserter Profitabilität.



Reduzierte Vertriebs- und Verwaltungskostenquote prognostiziert

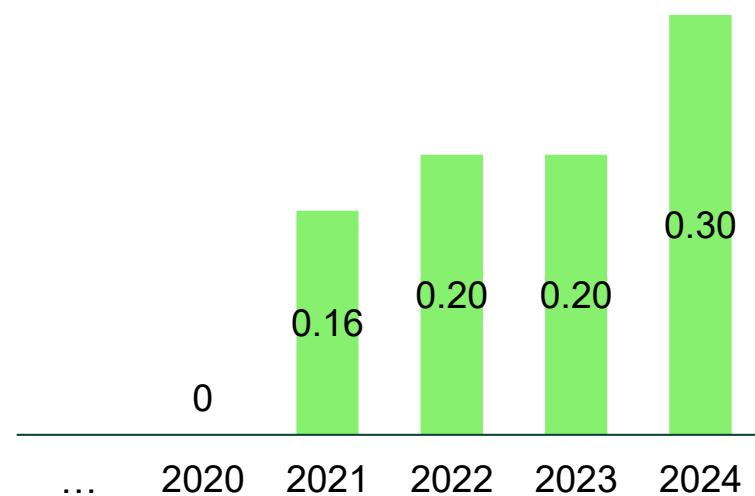
- **R&D-Ausgabenquote** soll steigen, um das Umsatzwachstum zu unterstützen
- **Vertriebs- und Verwaltungskostenquote** soll sich um ~ 2 bis 3 %-Punkte reduzieren, indem die Aufwendungen langsamer steigen als der Umsatz

F&E-Ausgabenquote
 Vertriebs- und Verwaltungskostenquote

Wir haben für die Jahre 2021 bis 2024 Dividenden in Höhe von 16,4 Millionen Euro ausgeschüttet

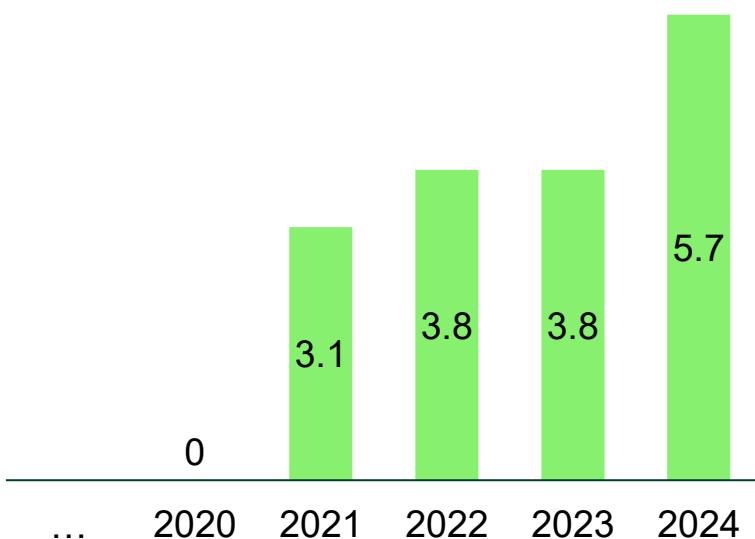
Dividendenausschüttung 2021 – 2024

(in € je Aktie; Auszahlung im Folgejahr)



Dividenenauszahlung gesamt 2021 – 2024

(in Mio. €; Auszahlung im Folgejahr)



SUSS hat im März 2022 die erste Dividendenpolitik verabschiedet; erste Ausschüttung somit für das GJ 2021.

Die Gesamtdividendenzahlungen für die Geschäftsjahre 2021 bis 2024 beliefen sich auf 16,4 Millionen Euro.



Dividendenpolitik

- Unsere Aktionäre sollen durch zuverlässige und angemessene Ausschüttungen am Erfolg des Unternehmens teilhaben.
- Gleichzeitig soll das Unternehmen über ausreichende Finanzmittel für das operative Geschäft und strategische Investitionen verfügen und eine angemessene Eigenkapitalquote aufrechterhalten.
- Dividendenrichtwert:
20 bis 40 % des konsolidierten Free Cashflows

Unser Ziel ist es, SUSS bis 2030 auf ein neues finanzielles Niveau zu führen.

	GJ 2024	GJ 2030A
Umsatz	446,1 Mio. €	750 - 900 Mio. €
Umsatzwachstum	46,6% (ggü. 2023)	9 - 13% (CAGR 2025 – 2030A ¹)
Bruttomarge (in %)	40%	43 - 45%
Vertriebs-/Verwaltungskosten	13,8% (vom Umsatz)	~11 - 12% (vom Umsatz)
F&E-Aufwendungen	9%	~11%
EBIT-Marge (in %)	16,8%	20 - 22%
Free Cashflow	25,3 Mio. €	~ 90 Mio. €
ROCE	36,8%	39 - 41%
Investitionen	7,6 Mio. €	~ 22 Mio. € (Durchschnitt p.a. 2026 – 2030)
Steuerquote	33,1%	~28% ²

¹ Durchschnittliches jährliches Wachstum ist berechnet auf Basis von 490 Mio. € im Jahr 2025; ² Die interne Planungsannahme für den Steuersatz beträgt in der Regel ~ 28 %.



Zeit für Ihre Fragen

Rechtlicher Hinweis

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Ergebnisse der SUSS MicroTec SE und ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Plänen, Schätzungen, Prognosen und Erwartungen und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die größtenteils schwer einzuschätzen sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der SUSS MicroTec SE liegen. Folglich können die tatsächlichen Entwicklungen sowie die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommenen abweichen.

Die SUSS MicroTec SE beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen.

Vielen Dank

Growing Innovation



Sven Köpsel

VP Investor Relations & Communications

Tel.: +49 89 32007-151

E-Mail: sven.koepsel@suss.com



Florian Mangold

Manager Investor Relations

Tel.: +49 89 32007-306

E-Mail: florian.mangold@suss.com